

技术参数

5302

日期: 01/13/2016

网址: www.stick1mat.com



应用

特点

单组分、热固化导电银胶，高触变性适用于高速点胶，小芯片 (<3*3mm) 具有优秀的粘接力以及高可靠性 (MSL1~3)

粘接基材

硅芯片，以及铜框架，镀银框架，PPF 框架，BT 树脂等

典型应用

固晶胶

固化前特性

特征	数值	测试方法
外观	银灰色	
粘度	8000cps	ASTM 0018
推荐固化条件	3~5°C/min 升温至 175°C， 并恒温 1 小时(逐渐升温可获得高可靠性、高导电率)	
固化条件	1hr@175°C	
热失重	<5% (推荐固化程序)	
比重	3.0~3.5g/ml	ASTM D-1875

固化后特性

特征	数值	测试方法
芯片剪切推力		
2×2 Si Die, 铜框架		
25	18kg	
200	3kg	
260	1.2kg	
2×2 Si Die, 镀银框架		
25	19kg	
200	3.5kg	
260	1.5kg	
储存模量		
@-60°C	4.7Gpa	DMA
@25°C	3.8Gpa	DMA
@200°C	1.8Gpa	DMA
@260°C	400Mpa	DMA
玻璃化温度	124°C	TMA
线性膨胀系数	$\alpha 1=38 \text{ ppm/}^\circ\text{C}$ $\alpha 2=145 \text{ ppm/}^\circ\text{C}$	TMA TMA

物理特性	数值	测试方法
体积电阻率 (推荐固化程序)	6×10E-5 ohm*cm	IEC 60167:1964,IDT
导热率	3.1W/mk	

技术参数

5302

日期: 01/13/2016

网址: www.stick1mat.com



可靠性	数值	测试方法
吸水率	0.60%	85°C/85%, 168hrs
芯片尺寸 (<2*2mm), SOT	MSL1~3	

使用及储运条件

使用及储存方法

点胶, 蘸胶等施胶方式均可; -40°C 保存, 使用前产品需要移到室温下回温, 5ml 包装至少解冻 1 小时再打开包装。使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触, 对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。

有效期

12 个月

包装

针筒包装, 罐装

注:

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺, 对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试评估。测试或使用中如有任何问题, 请联系本公司的技术支持。